

# 電子機器トータルソリューション展 2023

## 5.31 Wed. → 6.2 Fri. 10:00-17:00 東京ビッグサイト 東展示棟 2~6ホール+会議棟

### VIP 招待状

パソコン・スマホ等で事前登録 | バッジ印刷 | 会場でバッジホルダーをピックアップ | スムーズにご入場

www.jpccashow.com

VIP No. 230531

### 開催概要

協賛: JPCA Show 2023, JIEP, JISSO PROTEC 2023, Smart Sensing, E-Textile/Wearable, Edge Computing, IntarOpto, Imaging Japan

会期: 2023年5月31日(水)~6月2日(金) 10:00~17:00  
会場: 東京ビッグサイト 東展示棟2~6ホール+会議棟

### 電子機器トータルソリューション展 基調講演 (JPCA 創立60周年記念)

5月31日(水) 6月1日(木) 6月2日(金)

10:45-11:30 SDGs電子デバイス 半導体の未来

11:45-12:30 半導体/パッケージング 日本の半導体戦略

13:30-14:15 脱炭素社会の実現に向けて、ますます重要となるパワー半導体とアナログ技術

### JPCA 創立60周年記念特別講演 プログラム

5月31日(水) 6月1日(木) 6月2日(金)

14:30-15:30 エレクトロニクス産業とイノベーションの波

### JIEP 最先端実装技術シンポジウム

会場6F <A会場>605+606 <B会場>607+608

Time	A会場	B会場
9:45-10:40	01A-1 ロボットが繊細な力覚作業を行う社会を支える 小型・軽力量センサ(仮題) ~MEMS+金属構造体のハイブリッド実装による商品化~	01B-1 5G/6G に向けた高速・高周波用途向け基板材料の技術開発動向
10:40-11:35	01A-2 自動運転に向けたLiDAR技術の基礎と最新開発状況	01B-2 5G/6Gを見据えた高周波対応材料の技術・開発動向
11:35-12:30	01A-3 住友精密工業のMEMS事業について	01B-3 低伝送損失低遅延を実現する低誘電率、高接合ポリイミド樹脂(PIAD)
13:35-14:30	01A-2-1 自動運転を構成する技術 クラウド/エッジ/インフラ連携	01B-2-1 IOWN構想を支える光電融合実装技術(仮)
14:30-15:25	01A-2-2 ステレオカメラの認識技術とその応用	01B-2-2 企業にとってのメタバースとは(仮)
15:25-16:20	01A-2-3 自動運転のためのLiDAR技術	01B-2-3 2023~24年の電子機器と半導体市場展望
9:45-10:40	01A-1 クラウドデータセンターAIの動向と展開	01B-1 低炭素社会に貢献できる パワーデバイス・モジュール技術(仮)
10:40-11:35	01A-2 シリコンフォトニクスを用いた光電コネクタ/パッケージング/基板の研究開発	01B-2 次世代パワー半導体が貢献する「カーボンニュートラル」
11:35-12:30	01A-3 光回路技術による次世代コンピューティング(仮)	01B-3 GaO <sub>2</sub> /HfO <sub>2</sub> デバイスと独自の「ワーモジュール」社会実装を実現するグループ/IL/オンチップ企業
13:35-14:30	01A-2-1 自動車の脱炭素化/EV化の最新動向と関連技術(e-Axleや車載電池等)の今後の展望	01B-2-1 先端半導体対応パッケージング基板技術
14:30-15:25	01A-2-2 自動車用パワーエレクトロニクスの最新動向	01B-2-2 先端パッケージ・サブストレートを支えるコア材の最新動向
15:25-16:20	01A-2-3 (仮)車載用パワー半導体モジュールのパッケージング技術	01B-2-3 半導体基板 (FCBGA)の需要供給状況と今後の見通し
9:45-10:15	02A-1 先端実装の装置技術	02B-1 日の丸半導体復活、実現の鍵は...?
10:40-11:35	02A-2 マイクロエレクトロニクス実装技術 最新技術動向	02B-2 LSTCの先端半導体3Dパッケージングへの挑戦
11:35-12:30	02A-3 半導体設備のAR/VR、AIの採用動向	02B-3 ニップン半導体の再生における実装技術の重要性、最後まで最大の機会を活かせ
13:35-14:30	02A-2-1 AR/VR AI(仮想空間にリアルな世界を作り出す日本の底力)を牽引する実装技術	02B-2-1 [半導体の進化を支える、日本の基板技術]— HPC対応半導体/3D-Chip/InPに求められる記録基板とは、... —
14:30-15:25	02A-2-2 JEITA・電子部品技術ロードマップ—チップ部品、センサー部品を中心に—	02B-2-2 先端パッケージ・サブストレートを支えるコア材の最新動向
15:25-16:20	02A-2-3 100 Tb/s超スループットの実現に向けた光回路実装形態の予測と課題(仮)	02B-2-3 半導体基板 (FCBGA)の需要供給状況と今後の見通し

### ダントツものフリセセミナー

5月31日(水) 6月1日(木) 6月2日(金)

13:00-13:45 リーンなもののづくりセッション

13:45-14:30 特別講演1 飛躍的な生産性を実現する 全体最適の働き方イノベーション

14:35-15:35 コロナ2019年のヨコスカ改修事例

15:40-16:25 JPCAものづくり大賞大賞受賞

### 来場のご案内

電子機器トータルソリューション展はWEB登録制となります。事前にWEBにて登録をお願い致します。

STEP.1 公式ホームページより来場登録へお進みください。

STEP.2 ご登録いただいたメールアドレス宛に、パスワード設定のメールが届きます。24時間以内にパスワードの設定を完了してください。

STEP.3 展示会当日、来場者マイページより「来場者証(来場者バッジ)」をプリントアウトし、四つ折りの状態でご持参ください。

### 来場者参加型企画

ウェアラブル製品のデモ展示 | 実装体験コーナー | 主催者テーマ展示

### ブースコンテスト

指定の出展者を訪問するとオリジナルグッズがもらえるスタンプラリーを開催します!

### JISSO PROTEC 特別講演

5月31日(水) 6月1日(木) 6月2日(金)

10:30-11:20 スマートフォン・周辺機器業界見通し

### Electronics Component & Unit Show 特別講演

5月31日(水) 6月1日(木) 6月2日(金)

15:45-16:30 眼鏡フレーム技術を活かしたARグラスの産官学共同開発事例の紹介

### PROTEC セミナー

5月31日(水) 6月1日(木) 6月2日(金)

11:45-12:30 SDGsやカーボンニュートラルにフィットした後工程プロセスの省人化に貢献するデイスパンス技術の紹介

### JPCA プリント配線板技術ロードマップセミナー

5月31日(水) 6月1日(木) 6月2日(金)

13:00-14:00 2023年度版プリント配線板技術ロードマップ総論

### [JEITA] 半導体パッケージングセミナー

5月31日(水) 6月1日(木) 6月2日(金)

14:00-16:00 各日10:30~11:15 / 11:30~12:15実施予定

### E-Textile/Wearable セミナー

5月31日(水) 6月1日(木) 6月2日(金)

14:00-16:00 E-Textileアプリケーション(仮定)に向けたワイヤレス進捗報告セミナー

### 経済安全保障セミナー

5月31日(水) 6月1日(木) 6月2日(金)

13:00-14:30 経済安全保障の確保に向けて—技術・データ・製品等の流出防止—(仮)

### 熱関連セミナー

5月31日(水) 6月1日(木) 6月2日(金)

13:00-14:30 JPCA 熱関連セミナー

### 高信頼性車載用電子回路評価基準ガイドラインセミナー

5月31日(水) 6月1日(木) 6月2日(金)

10:30-11:15 高信頼性車載用電子回路評価基準ガイドラインセミナー

### Electronics Component & Unit Show 出展者セミナー

5月31日(水) 6月1日(木) 6月2日(金)

11:20-11:50 DXと新しいデジタルマーケティングの創出

### JIEP アカデミックプラザ

5月31日(水) 6月1日(木) 6月2日(金)

13:00-13:20 深層学習を用いた動体認識システムにおける

### 製品安全セミナー

5月31日(水) 6月1日(木) 6月2日(金)

13:00-13:40 デジタルツインを目指した高速度ビデオ画像診断のCuイ

※プログラムは都合により変更になる場合がありますので、予めご了承ください。

展示ホール セミナー会場 G NPIセミナー会場①	展示ホール セミナー会場 M NPIセミナー会場②
10:55-11:15 小型電子部品の筐体接着、防水・防塵シーリング処理、潤滑剤塗布を精密ホットメルトディスペンサで実現！ ノードン様	液晶ポリマー (LCP) 材料と繊維製品、電子部品への応用 寧波聚高新材料科技 (JUJIA)
11:35-11:55 表面改質の最新技術をご紹介！ (コーティング不要の撥液処理による液滴精度の向上、ガス不要の還元処理) 株式会社半導体	新商品フレキシブル基板 (FPC) 沖電線様
12:15-12:35 あらゆる計測器を同時監視！ソフトウェア開発歴26年の実績で挑む、IoT技術の新たな付加価値。 株式会社エージェンシー	エッジコンピューティングとクラウドの融合 Izuma Networks
13:35-13:55 高誘電率BT樹脂積層材料の紹介 三菱ガス化学様	自由自在な多段階配置で大小部品混載一括実装を実現するマルチステップマスク レーザーステップステーションの特長と性能～ 株式会社ブルックスジャパン
14:55-15:15 ウソオ電機の露光装置とエキシマ照射装置 ウソオ電機様	1Hリフローで実現する新しいものづくり 低耐熱・高放熱基板上での部品実装を量産まで対応 超低消費電力で、製造工程でのCO <sub>2</sub> 削減、SDGsに貢献 株式会社ワンダーフューチャーコーポレーション
10:55-11:15 基板及び電子部品加工向けレーザ加工機のご紹介 澁谷工業様	フレキシブル基板+ワイヤハーネス パワーデバイス材料の絶縁性能評価技術のご紹介 株式会社ニックス
12:15-12:35 CAD/CAMデータを活用したデータダイレクトソリューション ダイナト様	IoTデバイスの電源問題を解決！自立型IoTの社会実装を EnerCera で実現 日本ガイシ様
12:55-13:15 新フィルム状塗布システムの誕生 プリント基板露光技術について 株式会社・テクノロジ	FC-BGA 向け次世代BT樹脂積層材料の紹介 マッチ箱サイズの超コンパクトレーザ、MatchBoxシリーズの最新の動向とアプリケーション事例についてご紹介いたします。 フォトテクニカ様
14:15-14:35 BGA実装基板検査の課題を解決する JTAG/(バウンダリスキャン)テストのご紹介 アンドールシステムサポート様	プリント基板製造工程用研磨ホイール新商品のご紹介 《SR前パフカス詰まり対応研磨ホイール》 《穴埋めインク除去用研磨ホイール》 金井重要工業様
14:55-15:15 インクジェット塗布技術紹介 株式会社表記	基板にダメージを与えず微小物を確実に除去するために～Teknek のクリーニングの化学～ 株式会社ブルックスジャパン
15:35-15:55 DXと新しいデジタルマーケティングの創出 東亜無線電機様	DXと新しいデジタルマーケティングの創出 基板分割はレーザーカットの時代へ LPKFレーザードナリング (基板分割) 最新情報をお届け LPKF Laser & Electronics様
10:15-10:35 パワー半導体向け3Dプレス技術とシンタリング (焼結) 装置開発のご紹介 日機装機様	ファナックロボットの最新技術 ファナック様
10:55-11:15 素材の特性を見える化する！エレクトロニクス材料の熱分析と粘弾性測定 ティール・エイ・インストルメント・ジャパン様	微細回路形成用硫酸銅めっきプロセスのご紹介 メルテックス様
11:35-11:55 電子部品・半導体製造工程での DLC (ダイヤモンド・ライク・カーボン) コーティング活用事例。5G 通信帯域で使用可能な低誘電率 DLC など、各種機能性 DLC の紹介。 株式会社プラスマイオンアシスト	電子回路基板用ドリル、ルーターの最新技術情報 ユニオンツール様
12:55-13:15 カーボンニュートラル、低応力接合に対応可能な各種低温硬化型接着材料およびはんだペーストの紹介 日邦産業様	大口ロジック / 高速伝送用途 / 次世代 FOWLP および FOPLP 向け 奥野製薬工業の半導体パッケージ基板用 硫酸銅めっき添加剤 奥野製薬工業様
13:35-13:55 プリント基板設計 AI 自動配置ソリューションのご紹介 株式会社オンテック	LTSpice を PCB 設計に活用する。 (SW 電源部のトレスや VIA のインダクタンス成分に注目して) 株式会社三共

OITDA セミナー「産業の高度化・微細化に貢献する光・レーザ技術」 **無料** **要事前登録** 会議棟1階 102会議室

5月31日(水)	
10:25-10:30 主催者挨拶 小谷 泰久 (一財)光産業技術振興協会 副理事長兼専務理事	
10:30-11:15 レーザ加工のアライアンス取り組み (仮) 小林 洋平 東京大学 物性研究所 附属極端レーザー光科学研究センター 教授	
11:15-12:00 プリント基板加工の現状と将来 (仮) 金田 充弘 三菱電機様	
13:00-13:45 スマートグラス関連 (仮) 高木 将行 セイコーエプソン様	
13:45-14:30 マイクロ・ナノフォトニクス欧州エコシステムの可能性を探る (仮) カルロス・リー European Photonics Industry Consortium (EPIC) Director General	
14:30-15:15 Trends and Opportunities in the Photonics Industry ホセ・ボソ OPTICA (USA)	

interOpto/Imaging Japan 次世代通信に向けた光電融合技術セミナー **無料** **要事前登録** セミナー会場 J

6月1日(木)	
13:00-13:50 Society5.0時代の大容量情報通信を支える光・電波融合デバイス・システム基礎技術 山本 直寛 (国研) 情報通信研究機構 ネットワーク研究所 フォトニックICT研究センター・副センター長 / 先端ICTデバイスラボ・ラボ長 (兼任)	
13:50-14:30 光電融合を支えるハイブリッド光デバイスの開発 岡本 浩行 阿南工業高等専門学校 創造技術工学科 情報コース 教授	
14:30-15:10 集積光コム光源 (マイクロコム) と通信への応用 久世 直也 徳島大学ポストLEDフォトニクス研究所 次世代光研究部門 准教授	
15:10-15:40 フォトニックサイエンステクノロジーのファイバー製造技術とファイバ (部品) 開発技術 小林 壮一 フォトニックサイエンステクノロジー様 代表取締役社長	

テラヘルツテクノロジーフォーラム 第15回テラヘルツビジネスセミナー (THz.biz 2023) ~テラヘルツセンシングの応用展開~ **無料** **要事前登録** セミナー会場 J ※展示会場 (要事前登録) + Zoom 配信 (ハイブリッド開催)

5月31日(水)	
13:00-13:05 開会あいさつ/プログラム案内 林 伸一郎 テラテックフォーラム (情報通信研究機構) 戦略企画委員長	
13:05-13:35 THz (300GHz) 対応 Beyond5G/6G 向けアンテナ計測と空間電波可視化技術 杉山 武史 株式会社フォトニクスエッジ 代表取締役	
13:35-13:55 講演タイトル調整中 碓 智文 株式会社スペクトルデザイン 部長	
13:55-14:25 講演タイトル調整中 芹田 和剛 大阪大学 経営企画オフィス 准教授	
14:25-14:45 Beyond 5G に向けた材料・デバイスの周波数特性計測システムのご紹介 加藤 英志 株式会社バドテスト 新事業推進室 TAspjマネージャー	
14:45-15:15 講演タイトル調整中 門内 靖明 東京大学 大学院 情報理工学系研究科 システム情報学専攻 准教授	
15:15-15:35 300GHzフォックスルーポティスキャーの開発 大谷 知行 (国研) 理化学研究所 チームリーダー	
15:35-15:50 まとめ+NICFフレームワーク 齋藤 伸吾 (国研) 情報通信研究機構 (テラテックフォーラム) 主任研究員	

interOpto/Imaging Japan 企業プレゼンテーション **無料** **事前登録不要** セミナー会場 J

5月31日(水)	
11:30-11:50 高性能スキャニングオートコリレータ pulseCheckシリーズ紹介： 独国 APE 社製 フォトテクニカ様	
12:05-12:25 銅炭素複合材料による次世代ソフトエレクトロニクスデバイスの 放熱設計への展開 UBE 様	

6月1日(木)	
10:30-11:00 同時多波長測定を可能にするポリクロメータ式 光スベアナのご紹介 株式会社島津製作所	

出展者一覧

<b>スポンサー企業</b> <b>プラチナ</b> アドテックエンジニアリング ブイ・テクノロジ メコー  <b>ゴールド</b> アドテックジャパン イー・エス・アイ・ジャパン FICT ダイナト 太陽インキ製造 マグネット・パフォーマンス・ソリューションズ・ジャパン メック  <b>シルバー</b> 京亨 松和産業  <b>ブロンズ</b> 金井重要工業 JPCAめっき委員会 東亜無線電機 ニッコン工業  <b>JPCA Show</b> プリント記録板技術展 IMV IDAJ アン 鉅峰企業 actinano アスマ アドテックエンジニアリング アドテックジャパン アルメックステクノロジー イー・エス・アイ・ジャパン 石井表記 石原ケミカル いずみ製作所 出雲市 利送イーエムシー イチカワテクノファブリス 伊原電子工業 イキ インスペック インターエクスパート WECC (世界電子回路業界団体協議会) ウソオ電機 HAA 光学 HKPCA (香港線路板協会) エイト工業 エーティージー ルーサー アンド メルツァー FICT LPKF Laser & Electronics オーク製作所 オーツカ光学 大船企業日本 オカダジーエーエイ オンテック 鹿児島県 華正新材料 金井重要工業	カネカ 広島駿亜電子科技 北川精機 協栄プリント技研 京亨 清川メッキ工業 熊本県 クラボウ KFE Hong Kong KPCA (韓国電子回路産業協会) ケムックス ケムトロン 合成樹脂工業協会 神戸大学工学研究科 電気電子工学専攻 塚本・寺田研究室 Goal Searchers, ZHUHAI Korea Packaging Integration Association (KPIA) コムスキャンテック 相模ピーシーアイ 魁半導体 山本化学 三菱技研工業 CPICA (中国電子回路産業協会) ジェティディエイム J-RAAS JCU SHENGYI TECHNOLOGY 四合富士電子科技 四国化成工業 澁谷工業 橋本電機 橋本電機 富士通システム JADASON Enterprises ジャブ工業 JIANGXI JIANGNAN NEW MATERIAL TECHNOLOGY SHANDONG SHENGQUAN NEW MATERIALS Schmoll Maschinen 松和産業 ショウダテクトロン シライ電子工業 伸光製作所 新興電気 深圳市ニューセス企業 SHENZHEN JINZHOU PRECISION TECHNOLOGY Shenzhen Jingxin Electronic Technology Shenzhen Mason Electronics SCREEN PEソリューションズ ステラ ステラ・コーポレーション 大成ラミネーター ダイセル 守谷商事 ダイナトロン 大日光・エンジニアリング 太陽インキ製造 太洋工業 ダイワ ダイワ工業 タカノ タケウチ China Circuit Technology (Shantou) チュルリッパ 角田フロン製作所 ティンサーティー ジャパン TPCCA (台湾回路板協会) TESTONIC テスプロ TAESUNG	テノラ・ベルメック テンカ 電子回路企業年會基金 北川精機 電子情報技術産業協会 (WEITA) 電波新聞社 東京マシナ・アンド・ツール 中島化学産業 ニコン / ニコンソリューションズ ニッコン工業 日興運送 ニッコー・マテリアルズ 日東紡績 内藤電機工業 日放電子 カナルウオーター ニテックアパレルテクノロジー (旧-日本電産リード) 日本アプリアマテリアルズ 日本エレクトロ・チャールズ 日本電子回路工業会 (JPCA) 日本ビューテックス 日本ミクロン ハイテック 仙東 PAN-TEC ビアメカクス GIGAVIS PCBGOOGO 日立ハイテクサイエンス フェルネス 和仁貿易 フィッシャー・インストルメント ブイ・テクノロジ 福田金属箔工業 富士高分子工業 フジブリグループ 藤森工業 ブルックスジャパン ヘアック マイクロラフト コー マットエイト シライ電子工業 丸源機工所 ミカテクノス ミロ技術研究所 三菱ガス化学 メイコー MeiLink メック メルテックス モロロニクス エスペック 山形大学 YU-FIC ヤマハフインテック ユニオンツール 利昌工業 RYODEN (旧: 東電商事) レゾナック レヨーン工業 <b>3D-MID/パピリオン</b> 岩手県工業技術センター 大英 大英エレクトロニクス 太陽インキ製造 日本 MID 協会 ワンダーフューチャーコーポレーション ハニ化成	<b>半導体パッケージング・部品内蔵技術展</b> アズワン ADEKA AJ エクシール 奥野製薬工業 カルツワイス 三喜製作所 JSR 世紀精密 トワテック 内藤電機工業 長瀬産業 日本電気硝子 日本バーンズ 九州大学 フジエレクトロニクス クリニケム 群馬大学大学院 理工学府 公立諏訪東京理科大学 機械電気工学科 公立諏訪東京理科大学 地域連携開発機構 山陽小野田市立山口東京理科大学 シチメンファインデバイス 信州大学 工学部 電子情報システム工学科 先端磁気デバイス (佐藤・曾根原) 研究室 信州大学スピンドルデバイステクノロジーセンター 東海大学 東京工業大学 東京理科大学 東北大学 徳島大学 長野工業高等専門学校 中山研究室 長野工業高等専門学校 力丸研究室 日本カセエン PALMENS フォトテクニカ フジタ技術センター 生産改革研究部 先端システムグループ 北海道大学 工学研究科 米澤研究室 山形県工業技術センター 横浜国立大学	ビーエムティー 日立パワーソリューションズ 藤倉化成 フラズマイオンアシスト ミルコセミンダクタエンジニアリング  <b>アカデミックプラザ</b> 岩手大学 エクトコム 愛媛大学 大阪公立大学 沖エンジニアリング 神奈川県立産業技術総合研究所 ベントロン ポジション マルコム 武蔵エンジニアリング ヤマハ発動機 ルックス電子  <b>SDGsデバイス展</b> アップビス 産業タイムズ社  <b>WIRE Japan Show</b> 工業通信  <b>Electronics Component &amp; Unit Show</b> アルル電子 飯田通商 NNP 同本無線電機 グローバルディスプレイ コアスタッフ 三共社 成電社 成電社 奥田貿易 奥田電気 オムロン 化研テック 川崎重工業 サヤカ CKD JFE 商事エレクトロニクス UKUI ジュツジジャパン 設立電気工業 太平洋電機産業 タムラ製作所 テクノアルファ 東京大学 東洋理工 日本マン	日本スベリア社 日本ミルテック 日本ロボット工業会 (JARA) パーミジャン ハイウエイ ハスコ 白光 パナソニック コネクト ファナック FUJI ブルックス・ジャパン プロセス・ラボ・ミクロン ヘラーインダストリーズ・インク ベントロン ポジション マルコム 武蔵エンジニアリング ヤマハ発動機 ルックス電子  <b>SDGsデバイス展</b> アップビス 産業タイムズ社  <b>WIRE Japan Show</b> 工業通信  <b>Electronics Component &amp; Unit Show</b> アルル電子 飯田通商 NNP 同本無線電機 グローバルディスプレイ コアスタッフ 三共社 成電社 成電社 奥田貿易 奥田電気 オムロン 化研テック 川崎重工業 サヤカ CKD JFE 商事エレクトロニクス UKUI ジュツジジャパン 設立電気工業 太平洋電機産業 タムラ製作所 テクノアルファ 東京大学 東洋理工 日本マン	INTERNATIONAL OPTOELECTRONICS SOCIETY <b>interOpto</b> アイ・アール・システム アイオーコア アドコム・メディア アドバンテスト アルネアラボラトリ イー・アンド・イーエポリューション the international society for optics and photonics (SPIE) エム オプトニクス社 オンレンジアーチ 韓国光産業振興会 京都光技術研究会 SMK エネルギー・ハーベスティングコンソーシアム グラビコ 湖北工業 ジェニアルライト ジュー・イー・ウーラム・ジャパン 芝罘工業 島津製作所 Stella スペースフォトン スペクトルデザイン 産業技術総合研究所 住友電気工業 大興製作所 千歳市 / 公立千歳科学技術大学 Zhongshan Sichuan Optoelectronics Technology テクノハブズ テラヘルツテクノロジーフォーラム 東海エンジニアリングサービス 東莞市五豊電子 徳島大学ポストLEDフォトニクス研究所 長岡技術科学大学 パイオニクス 光学技術研究振興財団 光産業技術振興協会 (OITDA) 光電子融合基盤技術研究所 フォトテクニカ フォトニック・エッジ フォトニックサイエンステクノロジー 堀場製作所 マイクロンテック 丸文 UBE 理化学研究所 レーザ輸入振興協会 レーザ協会 Laser Focus World Japan  <b>Imaging Japan</b> ヴィ・エス・テクノロジ エバ・ジャパン サイバネットシステム 太平貿易 日通機械 三ツ波
---	---	--	--	--	---	---

Keynote Speech

5月31日(水)	
14:40-15:30 世界のトレンドからみたメーカーのトレンドとトコへの転換 上野 聡志 MODE, Inc. VP of Business	

6月1日(木)	
10:15-11:05 スマートセンシングとインターパス 持丸 正明 (国研) 産業技術総合研究所 人間拡張研究センター 研究センター長	
11:35-12:25 ＜ピッチステージ＞社会実装に進む磁歪振動発電機の製品開発と将来展望 未定	

6月2日(金)	
11:35-12:00 構内物流の自動化で実現するオペレーションの効率改善 三村 健二 株式会社イノベーション戦略事業本部 スマートシティ&モビリティ事業部 課長	
12:00-12:25 ライブデモで実演!! ヒト・モノの移動における無人化を見据えて ～モビリティデータ活用を取り組み～ 上原 拓 株式会社イノベーション戦略事業本部 スマートシティ&モビリティ事業部	

特別講演

6月1日(木)	
15:45-16:30 Animal DX 藤本 靖 南知社・ヒグマ情報センター 理事長	

企業プレゼンテーション

5月31日(水)	
13:45-14:25 多品種少量時代の難い方“半導体実装開発に付加価値あり” 安藤 孝 コネクティングジャパン様 取締役 常務執行役員	

6月1日(木)	
13:45-14:25 ディスプレイ技術を活用した新しいセンシング技術 神島 義晴 株式会社ディスプレイ 執行役員 チーフ・テクノロジ・オフィサー	
14:45-15:25 セキュアな省電力/長期供給の Arm搭載 CPU/ボド/ IoT ゲートウェイ「Armadiolo」 實吉 智裕 株式会社マークテクノ 代表取締役	

6月2日(金)	
12:45-13:25 自社の取り組みに役立つ企業事例から見る製造業 DX 大岡 明 株式会社産業革新研究所 取締役	
13:45-14:25 IoT = ニューノーマル 江川 裕峰 デザインインターナショナル様	
15:45-16:25 日本のデュアルユースロボットの行方 小林 賢一 ロボティクス普及促進センター 理事長 / 株式会社メディア 代表取締役	

3D-MID/パピリオンセミナー **無料** セミナー会場 E

5月31日(水)	
10:15-10:45 MIDの概要と、日本MID協会の活動紹介 松澤 清彦 日本MID協会 幹事	
11:00-11:30 JEITA 実装用MIDテクノカルレポートPG活動紹介 坂本 一三 電子情報技術産業協会 (JEITA) 電子実装技術標準化専門委員会 主査	
11:45-12:15 3D-MIDのためのエレメカ協同設計環境 松澤 清彦 株式会社EL 開発部 シニア・パートナー	

interOpto/Imaging Japan スマートライフ向け 光デバイス最新動向セミナー **無料** **要事前登録** セミナー会場 J

6月2日(金)	
10:30-11:10 ドローンを活用した農林水産業のスマート化 吉本 直人 公立千歳科学技術大学 理工学部電子工学科 教授	
11:10-11:40 "Improving Life with Photons" ("光"で生活を豊かにする) (仮) Luminus Devices 社 / 丸文様	
11:40-12:10 タイトル調整中 鈴木 敦志 E&E evolution様 代表取締役	

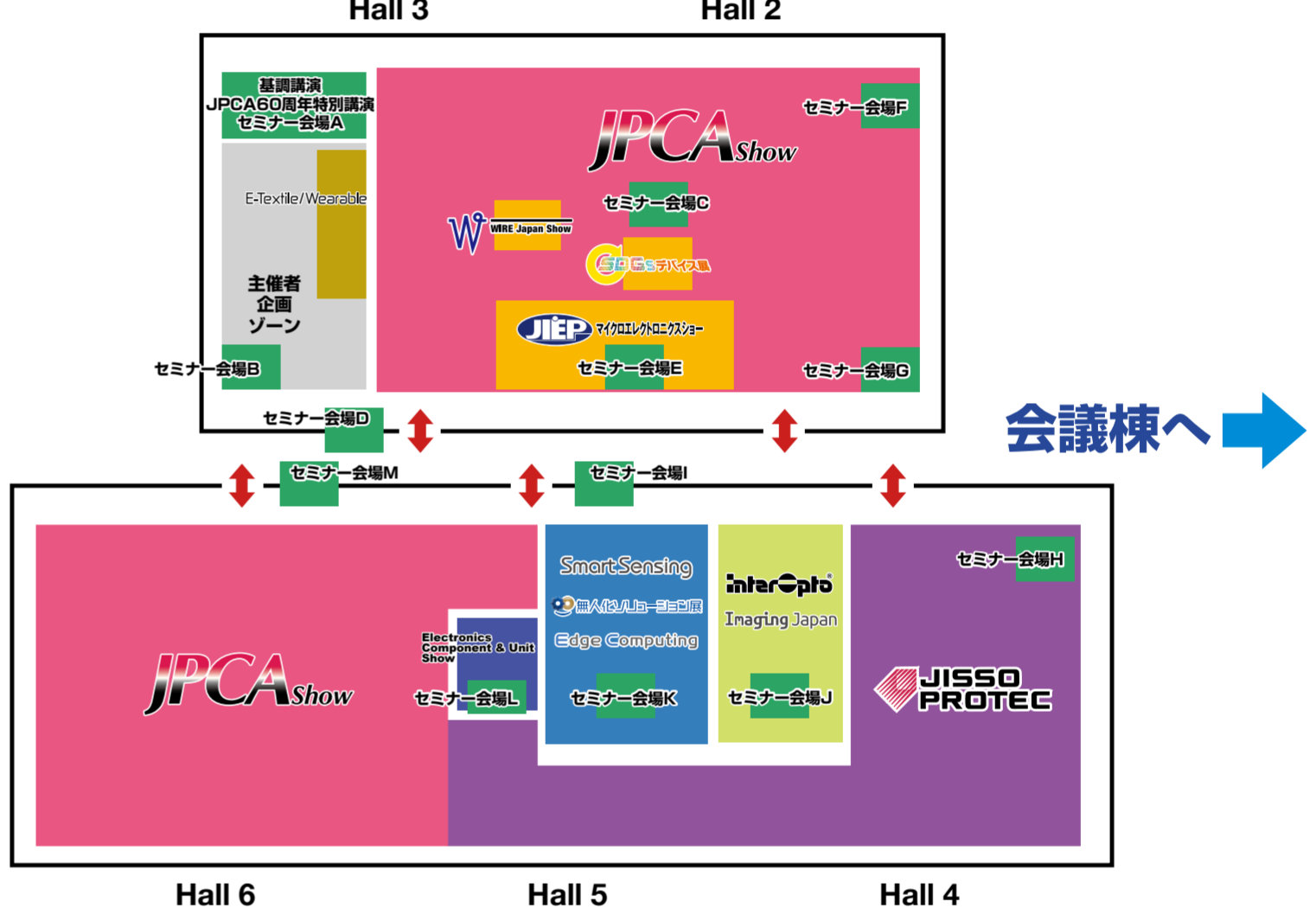
interOpto/Imaging Japan スマートファクトリー向けカメラ・センサー・システム最新技術セミナー **無料** **要事前登録** セミナー会場 J

6月2日(金)	
10:15-10:45 MIDの概要と、日本MID協会の活動紹介 松澤 清彦 日本MID協会 幹事	
11:00-11:30 分子接合技術による高周波伝送対応MIDの開発 目黒 和幸 (地独) 岩手県工業技術センター 機能材料技術部 上席専門研究員	
11:45-12:15 実装の最後の要「IHリフロー」で3D-MIDの社会実装を実現 岡庭 年春 株式会社ワンダーフューチャーコーポレーション 営業部 取締役営業部長	

注目される光技術セミナー **無料** **事前登録不要** セミナー会場 J

5月31日(水)～6月2日(金) 講演時間・タイトル・講演者は調整中

展示ホール内ゾーニング



会議棟へ

2023年3月22日(水) 現在 (展示会別・50音順)